

Spezifikation	Möglichkeiten
IPC-Klasse	IPC A 600 Klasse 2
min. Leiterplattengröße (Rohleiterkarte)	30 mm x 15 mm
min. Liefernutzengröße (Bestückung)	100 mm x 100 mm
max. Leiterplattengröße (Rohleiterkarte)	426 mm x 271 mm
max. Liefernutzengröße (Bestückung)	450 mm x 400 mm
umlaufender Rand Liefernutzen	10 mm
Leiterplattenmaterial	TG 150
Lagenanzahl	1 - 16 Lagen
Leiterplattendicken	0,50 / 0,80 / 1,00 / <b>1,55</b> / 2,00 / 2,40 / 3,20 mm
Strukturen Außen/Innenlagen	≥ 250µm (notwendig bei 105µm) ≥ 192µm (notwendig bei 70µm) ≥ 150µm ≥ 125µm ≥ 100µm (nicht IPC konform) ≥ 85µm (nur mit 18µm End CU)
Endkupfer außen/innen	18µm (keine galv. Metallisierung) 35µm / 70µm / 105µm
Kleinstes VIA	≥ 0,25mm (Pad ≥ 0,60mm) ≥ 0,10mm (Pad ≥ 0,45mm)
Kleinstes Fräsdurchmesser	≥ 1,60mm ≤ 1,50mm und ≥ 1,10mm ≤ 1,00mm und ≥ 0,50mm
Laserbohrungen (Micro-Via)	nein
Sacklöcher (Blind-Via)	optional
Anfasen	ja (20° und 45°)
Kantenmetallisierung	optional
Oberfläche	chem. Nickel/Gold HAL bleifrei chem. Zinn (Sn)
Selektiv galv. Gold mit Anbindung	optional
Lötstopplack	grün
Vollflächiger Farbdruck (alternativ)	Weiß, Gelb, Rot, Blau, Schwarz
Beschriftungsdruck (partiell)	Weiß, Gelb, Rot, Blau, Schwarz
Plugged Via	optional
E-Test	optional
UL-Kennzeichnung	optional
Lieferbeistellung	CoC, wenn gewünscht